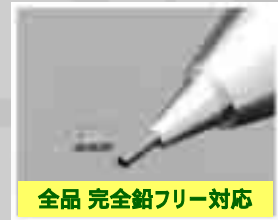


Multilayer Components

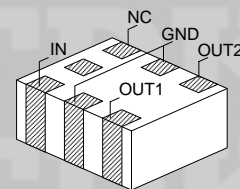
FDKは、独自の素材技術・シミュレーション技術・高周波回路技術をベースに、高周波回路・高周波モジュール用「積層チップインダクタ AMLシリーズ」「RFコンポーネント AMB / AMS / ALP / ABPシリーズ」を提供しております。第3～4世代携帯機器、モバイル機器用RFモジュールなどの小型設計に最適なチップを提供すべく、多彩なラインナップを取り揃えています。



全品 完全鉛フリー対応

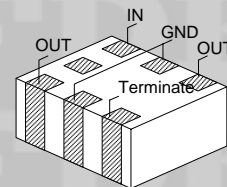
積層チップバラン

Item	Characteristics(typ.)
Dimensions	2.0x1.25x0.95mm
Center Frequency (fo)	2450.0MHz
Frequency Range	fo ± 50MHz
Insertion Loss	0.5dB (at fo ± 50MHz)
Unbalance Impedance	50ohm (nominal)
Balance Impedance	100ohm (nominal)



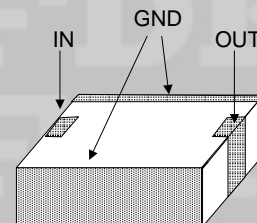
積層チップカプラ

Item	Characteristics(typ.)
Dimensions	2.0x1.25x0.95mm
Center Frequency(fo)	2450.0MHz
Frequency Range	fo ± 50MHz
Insertion Loss	0.3dB max (at fo ± 50MHz)
Coupling	14dB
Directivity	20dB



積層チップバンドパスフィルタ

Item	Characteristics(typ.)
Dimensions	2.5x2.0x t<1.0mm
Center Frequency (fo)	2450.0MHz (nominal)
Bandwidth (BW)	fo ± 50MHz
Characteristic Impedance	50ohm (nominal)
Insertion Loss in BW	0.8dB



当カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することや、製造を中止する事があります。ご注文に際しては弊社営業担当部門にご確認ください。